



PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro

Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICH NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : G03F 7/32, 7/42, C09K 13/06, H05K 3/06		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 95/23999		
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP95/00858		(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:	8. September 1995 (08.09.95)		
(22) Internationales Anmeldedatum: 6. März 1995 (06.03.95)		(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, SG, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).			
(30) Prioritätsdaten: 9404301.5 4. März 1994 (04.03.94) GB		Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>			
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH [DE/DE]; Erasmusstrasse 20-24, D-10553 Berlin (DE).					
(72) Erfinder; und					
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BARON, David, Thomas [GB/GB]; 9 Gloucester Way, Brewdley, Worcestershire DY12 1QF (GB). SMITH, Michael, Leonhard [GB/GB]; 16 George Frederick Road, Sutton Coldfield, West Midlands B73 6TB (GB). JOHAL, Kuldip, Singh [GB/GB]; 84 Hawkswell Drive, Hadley Heath, Willenhall, West Midlands WV13 3EJ (GB).					
(74) Anwalt: EFFERT, Udo; Radickestrasse 48, D-12489 Berlin (DE).					
(54) Title: AQUEOUS COMPOSITION FOR REMOVING POLYMER RESIST LAYERS FROM SUBSTRATE SURFACES AND ITS USE					
(54) Bezeichnung: WÄSSRIGE ZUSAMMENSETZUNG ZUM ENTFERNEN VON POLYMEREN RESISTSCHICHTEN VON SUBSTRATOBERFLÄCHEN UND DEREN ANWENDUNG					
(57) Abstract					
Aqueous compositions are disclosed for removing polymer resist layers from underlying surfaces, and the use of such compositions. Conventional aqueous solutions for removing polymer resist layers, for example from printed circuit cards, contain alkalinising agents, such as alkaline metal hydroxides or substituted ammonium hydroxides. Various additives are added to these solutions to prevent the composition from corroding the metallic surfaces of the printed circuit card. The removed resist material is substantially dissolved or suspended in the form of very small particles in the pickling composition. The disclosed pickling composition contains soluble silicates besides the alkalinising agents. Other additives are generally not required. These compositions remove the resists from the substrate surface in the form of large particles, so that their separation from the composition is possible without problems.					
(57) Zusammenfassung					
Die Erfindung betrifft eine wässrige Zusammensetzung zum Entfernen von polymeren Resistenschichten von darunterliegenden Oberflächen und die Verwendung derartiger Zusammensetzungen. Herkömmliche wässrige Lösungen zum Entfernen von polymeren Resistenschichten, beispielsweise von Leiterplatten, enthalten Alkalisierungsmittel, wie beispielsweise Alkalimetallhydroxide oder substituierte Ammoniumhydroxide. Um den Angriff der Zusammensetzung auf die Metallflächen der Leiterplatte zu verhindern, werden diesen Lösungen verschiedene weitere Additive zugegeben. Das entfernte Resistmaterial wird in der Entschichtungszusammensetzung im wesentlichen aufgelöst oder in sehr kleinen Teilchen in dieser suspendiert. Die erfundungsgemäße Entschichtungszusammensetzung enthält neben den Alkalisierungsmitteln zusätzlich lösliche Silikate. Weitere Zusätze sind in der Regel nicht erforderlich. Mit diesen Zusammensetzungen werden die Resiste in großen Teilchen von den Substratoberflächen entfernt, so daß deren Entfernung aus der Zusammensetzung problemlos gelingt.					

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	GA	Gabon	MR	Mauretanien
AU	Australien	GB	Vereinigtes Königreich	MW	Malawi
BB	Barbados	GE	Georgien	NE	Niger
BE	Belgien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland
BJ	Benin	IE	Irland	PL	Polen
BR	Brasilien	IT	Italien	PT	Portugal
BY	Belarus	JP	Japan	RO	Rumänien
CA	Kanada	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CG	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SI	Slowenien
CI	Côte d'Ivoire	KZ	Kasachstan	SK	Slowakei
CM	Kamerun	LI	Liechtenstein	SN	Senegal
CN	China	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
ES	Spanien	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	ML	Mali	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MN	Mongolei	VN	Vietnam

Wäßrige Zusammensetzung zum Entfernen von polymeren Resistenschichten von Substratoberflächen und deren Anwendung

10 Die Erfindung betrifft eine wäßrige Zusammensetzung zum Entfernen von polymeren Resistenschichten von darunterliegenden Oberflächen und die Verwendung derartiger Zusammensetzungen.

15 Polymere Resistenschichten werden angewendet, wenn nur bestimmte vorgezeichnete Bereiche auf Oberflächen behandelt und insbesondere wenn kleine oder verzweigte Strukturen oder Muster bei der Herstellung von Leiterplatten gebildet werden sollen. Resiste werden als Überzüge auf die zu behandelnden Oberflächen aufgebracht und anschließend gehärtet, mit Ausnahme der Bereiche an der Oberfläche, die nachfolgend noch zu behandeln sind.

20 Üblicherweise wird der Resist durch Photoprozesse ausgehärtet, wobei er entsprechend dem gewünschten Muster mittels einer geeigneten Maske mit Licht oder anderer elektromagnetischer Strahlung bestrahlt wird. Die nicht ausgehärteten Bereiche werden in einer chemischen Entwicklungslösung entfernt, so daß die entsprechenden Bereiche an der Oberfläche für die nachfolgenden Behandlungsschritte freigelegt werden.

25 Mögliche weitere Behandlungsschritte sind das Entfernen von Metall, typischerweise durch Ätzen, und die Abscheidung von Metall. Auch andere Prozeßschritte sind möglich.

2.

Nach der Behandlung wird die ausgehärtete Resistenschicht von den bisher geschützten Bereichen entfernt.

- 5 Zur Herstellung von Resisten werden Polymere verwendet. Üblicherweise sind dies Acrylatpolymere oder -copolymere. Diese Polymere sind durch Photoprozesse aushärtbare Stoffe. Die Resiste können beispielsweise in Form von Filmen angewendet werden, die auf die Substratoberfläche mittels Wärme auflaminiert werden. Es gibt eine große Vielfalt verschiedener Resiste. Andere
- 10 Resisttypen werden beispielsweise in flüssiger Form auf die zu behandelnden Oberflächen unter Bildung der Resistenschichten aufgebracht. In einer weiteren Variante werden die Resistenschichten durch elektrophoretische Verfahren aus Suspensionen gebildet.
- 15 Geeignete Resiste und deren Zusammensetzung sind beispielsweise in den Druckschriften EP-A 0 236 950, US-A 33 80 831 und US-A 29 27 022 beschrieben.
- 20 Zur Entschichtung von Resisten nach dem Ätz- oder Metallisierungsverfahren werden organische Lösungsmittel als Entschichtungsmittel verwendet. Diese haben sich für die Entfernung der Polymerschichten als besonders wirksam herausgestellt. Diese Lösungen weisen bei deren Einsatz und bei der Entsorgung jedoch entscheidende Nachteile auf.
- 25 Durch Fortschritte auf dem Gebiet der Resistmaterialien wurde daher deren allmählicher Ersatz durch wässrige und halbwässrige alkalische Zusammensetzungen, basierend auf Hydroxiden, insbesondere Kaliumhydroxid, oder Aminen, insbesondere Alkanolaminen, möglich. Teilweise wurden auch wasserlösliche, organische Stoffe, wie beispielsweise Alkoxyalkohole, mit den
- 30 wässrigen Alkalihydroxiden gemischt. Deren Verwendung ist jedoch rückläufig.

3.

Durch wäßrige Lösungen von Kaliumhydroxid werden Resistpolymere wirksam entfernt. Jedoch neigen diese Lösungen dazu, die Polymere abzubauen und aufzulösen, wobei die Wirksamkeit der Entschichtungslösung reduziert wird.

5 Eine einfache Aufarbeitung von gebrauchten Entschichtungslösungen ist beispielsweise wegen der erhöhten Anforderungen an die Abwasserreinheit jedoch unabdingbar. Gelingt die Aufarbeitung von abgebauten bzw. aufgelösten Resistpolymeren enthaltenen Entschichtungslösungen nicht, so verringert sich die Standzeit bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Lösung wegen nicht mehr ausreichender Wirksamkeit verworfen und entsorgt werden muß. Da die Lösungen dann einen hohen Gehalt an organischen oxidierbaren Verbindungen aufweisen, müssen diese entfernt werden. Da die Resistbestandteile in der Lösung gelöst sind, können diese jedoch nicht leicht entfernt werden. Daher stellen die aufgelösten Polymere in der gebrauchten Hydroxid-Lösung auch bei der Abwasseraufbereitung ein Problem dar.

10

15 Andere Entschichtungslösungen auf der Basis von Alkanolaminen müssen zusätzlich weitere Verbindungen enthalten, um die Resistentfernung zu beschleunigen, den Angriff auf empfindliche Metalloberflächen (z.B. Zinn/Bleiliegierungen) zu inhibieren und die Passivierung exponierter Oberflächen, insbesondere von Kupfer, während und nach einem Trocknungsprozeß zu verhindern. Die mit Zusätzen versehenen Alkanolamin-Zusammensetzungen sind zum Entschichten gut geeignet und neigen in geringerem Maße dazu, Polymere aufzulösen, als Kaliumhydroxid-Lösungen.

20

25 Trotzdem bereiten auch diese Entschichtungszusammensetzungen bei der Abwasseraufbereitung Probleme. Insbesondere die Alkanolamine selbst und vor allem zu diesen Lösungen zugegebene Komplexbildner, wie beispielsweise Ethyldiamintetraessigsäure (EDTA) oder deren Salze, die einen chemischen Angriff auf die zu behandelnden Oberflächen durch Inhibierung verhindern

30 sollen, führen zu einem hohen chemischen und biologischen Sauerstoffbedarf

4.

im Abwasser und müssen wegen deren Komplexbildnereigenschaft aus dem Abwasser fast vollständig entfernt werden.

5

Der vorliegenden Erfindung liegt von daher das Problem zugrunde, eine neue Entschichtungszusammensetzung zum Entfernen von polymeren Resistschichten zu finden.

10 Das Problem wird gelöst durch die Ansprüche 1 und 9. Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.

15 Die Aufgabe wird insbesondere durch wäßrige Silikatzusammensetzungen, insbesondere wäßrige Lösungen, gelöst. Diese Zusammensetzungen ergeben brauchbare Resultate. Derartige Lösungen sind in der Lage, ausgehärtete polymeren Resistschichten von einer darunterliegenden Metalloberfläche problemlos zu entfernen. Zu diesem Zweck wird in der Lösung üblicherweise ein pH-Wert von wenigstens 9,5 und insbesondere von wenigstens 10,5 eingestellt.

20

Die wäßrige Lösung enthält neben dem löslichen Silikat typischerweise zusätzlich starke organische oder anorganische Basen, beispielsweise Alkanolamine oder Alkalihydroxide oder substituierte Ammoniumhydroxide, wie beispielsweise Tetramethylammoniumhydroxid, als Alkalisierungsmittel.

25

Überraschenderweise wurde gefunden, daß die Verwendung von Silikat die für die Entfernung der Resistschichten erforderliche Menge des Alkalisierungsmittels reduziert. Dadurch werden die negativen Begleiterscheinungen, die bei Verwendung bestimmter Alkalisierungsmittel immer auftreten, reduziert.

30

Darüber hinaus wurde auch eine verringerte Tendenz der Entschichtungslösung

5.

gefunden, metallische Oberflächen, die der Lösung beim Entschichten ausgesetzt sind, beispielsweise vor allem Kupfer-, Zinn/Blei-, andere Zinnlegierungs- und Goldlegierungsschichten, alkalisch anzugreifen, wenn Silikate verwendet werden. Dadurch ist es möglich, die Konzentration von Additiven, die der Lösung üblicherweise zur Inhibierung gegen einen solchen Angriff zugegeben werden, beispielsweise Komplexbildner wie EDTA, zu verringern oder deren Verwendung gänzlich zu vermeiden. Ferner können auch Additive, wie beispielsweise Ammoniak, das üblicherweise verwendet wird, um die Schäden, die wiederum durch EDTA verursacht werden, zu vermeiden, in geringerer Konzentration eingesetzt oder gänzlich vermieden werden.

10 Dadurch ist ein Entschichtungssystem von unvorhergesehener Einfachheit möglich, das im wesentlichen ausschließlich auf einer Kombination der Alkalisierungsmittel und den Silikaten basiert.

15 Als geeignete lösliche Silikate werden Alkalimetallsilikate, vorzugsweise Natrium- und Kaliumsilikate, Ammoniumsilikate und substituierte Ammoniumsilikate, beispielsweise Tetramethylammoniumsilikat, verwendet. Der Strukturtyp der verwendeten Silikate in fester Form vor der Auflösung, beispielsweise 20 Metasilikat oder Orthosilikat, scheint sich nicht auf die Wirkung der Silikate auszuwirken. Beispielsweise ergeben sowohl Natriumorthosilikat als auch Natriummetasilikat gleich brauchbare Ergebnisse.

25 In gewissem Umfange können die Silikate durch bekannte Zusätze ersetzt werden, um eine vergleichbare Wirkung wie mit Entschichtungszusammensetzungen ohne herkömmliche Zusätze zu erreichen. Die untere Konzentrationsgrenze der Silikate in der Entschichtungszusammensetzung liegt üblicherweise bei 0,01 Gew.-%, typischerweise jedoch bei 0,1 Gew.-% und bevorzugt bei 0,5 Gew.-%. Üblicherweise sollte die obere Konzentrationsgrenze 20 30 Gew.-% nicht überschreiten. Typischerweise liegt die obere Konzentration-

6.

grenze bei 10 Gew.-% und vorzugsweise bei 6 Gew.-%. Auch die Silikatkonzentration wirkt sich innerhalb der angegebenen Konzentrationsbereiche nicht wesentlich auf das Entschichtungsergebnis aus.

5 Gewünschte Verhältnisse von Silikat in der Zusammensetzung, angegeben in g Silizium im Silikat/Liter, liegen üblicherweise zwischen 0,02 und 40, typischerweise zwischen 0,2 und 20 und vorzugsweise zwischen 0,1 - 12.

Der Entschichtungszusammensetzung wird ein Alkalisierungsmittel in einer 10 Menge zugegeben, um einen zum Entschichten ausreichenden pH-Wert einzustellen. Alkanolamine mit typischerweise ein bis zehn Kohlenstoffatomen, beispielsweise Ethanolamin, sind hierfür gut geeignet.

Auch Cholinbasen können verwendet werden. Lösliche Hydroxide, wie Alkalimetallhydroxide, insbesondere Kaliumhydroxid, und substituierte 15 Ammoniumhydroxide, wie beispielsweise Tetramethylammoniumhydroxid, sind ebenso geeignet. Es hat sich herausgestellt, daß diese Mittel in Mengen eingesetzt werden können, die geringer sind als in herkömmlichen Entschichtungszusammensetzungen, um denselben Effekt zu erreichen.

20 Ein lösliches Hydroxid wird üblicherweise in einer Konzentration von 0,02 Mol/Liter bis 3,5 Mol/Liter Zusammensetzung, insbesondere von 0,1 Mol//Liter bis 1 Mol/Liter Zusammensetzung und vorzugsweise unterhalb von 0,5 Mol/Liter Zusammensetzung verwendet. Daher ist beispielsweise eine Konzentration von 0,1 Gew.-% bis 20 Gew.-%, insbesondere von 0,5 Gew.-% bis 6 25 Gew.-% und vorzugsweise unter 3 Gew.-% für Kaliumhydroxid geeignet.

Ein Alkanolamin wird üblicherweise bei einer Konzentration von 0,02 Mol/Liter bis 5 Mol/Liter Zusammensetzung, vorzugsweise von 0,1 Mol/Liter bis 2,5 30 Mol/ Liter Zusammensetzung und insbesondere unterhalb von 1 Mol/Liter Zu-

7.

sammensetzung eingesetzt. Dies entspricht beispielsweise Werten zwischen 0,1 Gew.-% und 30 Gew.-%, vorzugsweise von 0,5 Gew.-% bis 15 Gew.-% und üblicherweise unterhalb von 6 Gew.-% für Monoethanolamin.

5 Es hat sich herausgestellt, daß die Silikat enthaltenden Zusammensetzungen zur Entschichtung der üblichen polymeren Resisten geeignet sind und unter den üblichen Entschichtungsbedingungen verwendet werden können. Vorteilhaft ist, daß die Zusammensetzungen keine organischen Chelat- und Komplexierungsmittel enthalten, wie beispielsweise EDTA.

10 In den Zusammensetzungen können beispielsweise weiterhin oberflächenaktive Verbindungen enthalten sein. Es können die herkömmlichen oberflächenaktiven Verbindungen verwendet werden. Deren Zweck besteht darin, Metallocerflächen während und nach dem Trocknen zu schützen, die Entschichtung zu beschleunigen, indem sie die Benetzung der Oberfläche verbessern, und um die Schaumbildung zu verhindern, die durch den Abbau der polymeren Resiste verursacht wird. Nichtionische oberflächenaktive Verbindungen, beispielsweise ethoxylierte tertiäre Amine, sind gut geeignet. Typische Konzentrationen liegen zwischen 0,1 g/Liter und 5 g/Liter Zusammensetzung.

15 20 Schaumhemmende Mittel können ebenso wie in herkömmlichen Entschichtungslösungen enthalten sein. Geeignete schaumhemmende Mittel, von denen einige oberflächenaktive Verbindungen sind, sind bekannt. Die Konzentration dieser Verbindungen liegt üblicherweise zwischen 0,1 g/Liter und 5g/Liter Zusammensetzung.

25 Neben Wasser als Lösemittel können die Zusammensetzungen weiterhin mit Wasser mischbare organische Lösemittel wie Ethoxyalkohole, beispielsweise Butoxyethanol und dessen Analoge, enthalten. Jedoch ist eine Zugabe von 30 organischen Lösungsmitteln nicht bevorzugt.

8.

Mittel zur Verhinderung der Passivierung der Metallflächen, wie Benzotriazol, können ebenso wie bei herkömmlichen Entschichtungszusammensetzungen enthalten sein. In der erfindungsgemäßen Zusammensetzung werden diese jedoch vorzugsweise nicht verwendet, da sich herausgestellt hat, daß die Passivierung in vielen Fällen auch durch die Silikate vermieden werden kann.

Die Entschichtungszusammensetzung kann sowohl durch aufeinanderfolgende Auflösung der in fester Form vorliegenden Silikate und Alkalisierungsmittel sowie gegebenenfalls weiterer Zusätze in Wasser oder in einer wässrigen Lösemittelzusammensetzung, enthaltend zusätzlich organische Lösemittel, hergestellt werden. Ferner kann auch zunächst eine Mischung von wasserlöslichen Feststoffen der Bestandteile der Zusammensetzung eingesetzt werden, um die Entschichtungslösung herzustellen. Es können zunächst auch eine oder mehrere konzentrierte Lösungen der einzelnen Bestandteile der Lösungen hergestellt werden, die dann zum Gebrauch verdünnt und miteinander vermischt werden.

Die Entschichtungszusammensetzung kann vorteilhaft in einem Verfahren zum Entfernen einer gehärteten polymeren Resistenschicht von einer darunterliegenden Metallocberfläche eingesetzt werden, beispielsweise von einer Leiterplatte. Das Verfahren besteht darin, die Resistenschicht so lange mit der erfindungsgemäßen Entschichtungszusammensetzung in Kontakt zu bringen, bis die Resistenschicht entfernt ist. Die Art der Resistenschicht ist hierbei üblicherweise nicht wesentlich. Es wurden Resistete verschiedener Typen wirksam entfernt, wie beispielsweise Acrylatpolymere und Acrylatcopolymere.

Die die Resistenschichten tragende Metallocberfläche kann auf einem dielektrischen Träger aufgebracht sein. Dies ist beispielsweise bei Leiterplatten der Fall. Geeignete dielektrische Trägermaterialien schließen unter anderem Harze aus Polyimid, Phenolharz, Polytetrafluorethylen, Siliziumdioxid und Epoxidharz, das beispielsweise mit Glas verstärkt sein kann, ein. In den meisten Fällen wird

9.

als darunterliegendes Metall Kupfer verwendet.

Das Substrat mit den zu entfernenden Resistenschichten kann mit der Entschichtungszusammensetzung auf unterschiedliche Weise in Kontakt gebracht werden, beispielsweise durch Sprühen oder Schwallen einer flüssigen Entschichtungszusammensetzung auf die Substratoberflächen sowie durch Eintauchen des Substrats in die flüssige Entschichtungszusammensetzung.

Die optimale Behandlungstemperatur kann durch Versuche leicht ermittelt werden. In herkömmlichen Verfahren sind normalerweise Temperaturen von 40 °C bis 60 °C zufriedenstellend. Dasselbe gilt im vorliegenden Falle.

In gleicher Weise kann die zur Entfernung der Resistenschichten benötigte Behandlungsdauer durch Versuche problemlos bestimmt werden. Übliche Behandlungszeiten in der Größenordnung von 30 Sekunden bis zwei Minuten sind normalerweise angemessen.

Es ist wünschenswert, daß die Entschichtungszusammensetzung den Resist so entfernt, daß ziemlich kleine Teilchen entstehen, um eine sorgfältige Entfernung auch von feinen Oberflächenstrukturen, beispielsweise zwischen den Leiterzügen einer Leiterplatte, zu ermöglichen. Es hat sich herausgestellt, daß die erfindungsgemäßen Entschichtungszusammensetzungen diesen Anforderungen genügen, indem mittlere Teilchengrößen des entfernten Resists im gewünschten Bereich von 1 mm bis einige mm ohne Schwierigkeiten erreicht werden können. Derartige Teilchen können durch geeignete Filtersysteme problemlos entfernt werden.

Aus wirtschaftlichen Gründen und aus Gründen des Umweltschutzes ist eine Wiederaufarbeitung der Entschichtungszusammensetzung äußerst wünschenswert. Hierzu wird die Entschichtungszusammensetzung mittels geeigneter

Filtersysteme mechanisch von den in der Zusammensetzung suspendierten Teilchen des polymeren Resists befreit.

Eine Anwendung von besonderer Bedeutung ist die Herstellung von Leiterplatten. Die beschriebene Entschichtungszusammensetzung und das Verfahren zur Entschichtung von polymeren Resisten können zur Herstellung von Leiterplatten eingesetzt werden. Das Herstellungsverfahren umfaßt die folgenden Verfahrensschritte:

- 10 (a) Aufbringen einer Metallschicht auf einen dielektrischen Träger,
- (b) Überziehen der Metallschicht mit einer polymeren Resist-
 schicht in nicht ausgehärtetem Zustand,
- (c) Strukturieren der Resistenschicht durch Aushärten ausge-
 wählter Bereiche der Schicht mittels Belichtung (vorzugs-
 weise durch Ultraviolettrstrahlung), während andere Berei-
 che nicht ausgehärtet werden,
- 15 (d) Entwickeln der belichteten oder unbelichteten Struk-
 tur, indem die nicht ausgehärteten Bereiche der Re-
 sistenschicht entfernt werden (vorzugsweise mit einer
 Entwicklungsflüssigkeit) und Freilegen der entspre-
 chenden Bereiche der Metallschicht,
- 20 (e) Chemisches Behandeln der freigelegten Bereiche der Metall-
 schicht, typischerweise durch Abätzen dieser Bereiche oder
 durch Abscheiden von Metall auf diesen Bereichen und
- 25 (f) Entschichten der ausgehärteten Bereiche der Resistenschicht von
 der darunterliegenden Metallschicht mit der erfindungsgemäßen
 Zusammensetzung.

Die Schritte (a) bis (e) können nach einem bekannten Verfahren durchgeführt werden.

Nachfolgende Beispiele sollen die Erfindung näher erläutern.

5 Entschichtungszusammensetzungen wurden, wie nachfolgend beschrieben, hergestellt. Ein Versuchswerkstück wurde in die Entschichtungszusammensetzungen eingetaucht. Als Versuchswerkstück wurde eine mit Kupfer überzogene Leiterplatte verwendet, auf die nach dem Aufbringen und Photostrukturieren einer polymeren Resistorschicht eine Schicht von Kupfer mit einer mittleren Dicke von 25 µm und eine Schicht einer Zinn/Blei-Legierung mit einer mittleren Dicke von 5 µm nacheinander abgeschieden worden waren. In dem Versuch wurde die erforderliche Zeit zur vollständigen Entschichtung der Metallocberfläche auf dem Werkstück von der Resistorschicht und der Teilchengrößenbereich des entschichteten Resistsmaterials gemessen sowie der Zustand der Metallocberflächen des Versuchswerkstückes nach dem Entschichten und Trocknen bestimmt.

10

15

20 Beispiel 1 (Vergleichsversuch, herkömmliche Entschichtungszusammensetzung):

Monethanolamin	4,5 Gew.-%
Amoniak	0,16 Gew.-%
EDTA	0,09 Gew.-%
25 Rest Wasser	
Resisttyp	Thiokol HG (Firma Morton International, Inc. Tustin, USA)
Temperatur	50-55 °C

Ergebnisse:

	Entschichtungszeit	53 Sekunden
	Teilchengröße	1 - 3 mm
5	Cu- und Sn/Pb-Oberflächen	Keine Fleckenbildung/Passivierung

10 Diese herkömmliche, auf Alkanolaminen basierende Zusammensetzung ergibt gute Entschichtungsergebnisse und Teilchengrößen. Jedoch enthält die Zusammensetzung EDTA und Ammoniak, um einen Angriff auf die Metalloberflächen zu verhindern, beispielsweise durch Oxidation und Passivierung.

15 Beispiel 2:

	Monethanolamin	1,2 Gew.-%
	Natriumorthosilikat	2,5 Gew.-%
	Rest Wasser	
20	Resisttyp	DuPont 4215 (Firma DuPont de Nemours and Comp., Wilmington USA)
	Temperatur	50-55 °C

25
Ergebnisse:

	Entschichtungszeit	55 Sekunden
	Teilchengröße	1 - 3 mm
30	Cu- und Sn/Pb-Oberflächen	keine Fleckenbildung/Passivierung

rung

Es wurde eine vergleichbare Entschichtungsleistung wie bei Beispiel 1 erreicht ohne Angriff der Metalloberflächen, obwohl der Gehalt an Monoethanolamin
5 erheblich reduziert wurde und die Zusammensetzung kein EDTA und kein Ammoniak enthielt, indem Silikat eingesetzt wurde.

10

Beispiel 3 (Vergleichsversuch):

	Kaliumhydroxid	3 Gew.-%
	Rest Wasser	
15	Resisttyp	Thiokol HG
	Temperatur	50 - 55 ° C
	Ergebnisse:	
20	Entschichtungszeit	55 Sekunden
	Teilchengröße	1 - 3 mm
	Sn/Pb-Oberflächen	keine Fleckenbildung/Passivierung
25	Cu-Oberfläche	orangefarbene Passivierung beobachtet

Die Resistsschicht wurde durch eine herkömmliche Entschichtungszusammensetzung auf Kaliumhydroxid-Grundlage wirksam entfernt. Jedoch wurde das
30 freigelegte Kupfer passiviert. Ein erheblicher Anteil des entfernten Resists ging

14

dabei in Lösung und wurde nicht in Form kleiner Teilchen in die Entschichtungslösung gebracht.

5 Beispiel 4:

Kaliumhydroxid	2,5 Gew.-%
Natriummetasilikat Pentahydrat	3 Gew.-%
Rest Wasser	

10

Resisttyp	Thiokol HG
Temperatur	50 - 55 °C

Ergebnisse:

15

Entschichtungszeit	58 Sekunden
Teilchengröße	1 - 4 mm
Cu- und Sn/Pb-Oberflächen	keine Fleckenbildung/Passivierung

20

Durch Verwendung von Silikat wurde eine Passivierung vermieden. Gleichzeitig wurde eine vergleichbare Entschichtungsleistung mit einem geringeren Kaliumhydroxid-Gehalt als im Vergleichsversuch (Beispiel 3) ermöglicht.

25

Beispiel 5:

Kaliumhydroxid	2 Gew.-%
Natriumorthosilikat	0,7 Gew.-%
Rest Wasser	

15

Resisttyp DuPont 9015
Temperatur 50 - 55 °C

Ergebnisse:

5

Entschichtungszeit 57 Sekunden
Teilchengröße 2 - 5 mm
Cu- und Sn/Pb-Oberflächen keine Fleckenbildung/Passivierung

10

Mit diesem Beispiel wird gezeigt, daß Orthosilikat ermöglicht, eine geringere Menge von Kaliumhydroxid zu verwenden und gleichzeitig die Bildung von Flecken zu vermeiden.

15

Beispiel 6:

Kaliumhydroxid 1,7 Gew.-%
Natriummetasilikat Pentahydrat 2,1 Gew.-%
20 Rest Wasser

Resisttyp: DuPont 4215
Temperatur: 50 - 55 °C

25 Ergebnisse:

Entschichtungszeit 68 Sekunden
Teilchengröße 1 - 2 mm
Cu und Sn/Pb Oberflächen keine Fleckenbildung/Passivierung

30

10 **Wäßrige Zusammensetzung zum Entfernen von polymeren Resistenschichten von Substratoberflächen und deren Anwendung**

Patentansprüche:

15

1. Wäßrige Zusammensetzung zum Entfernen von polymeren Resistenschichten von Substratoberflächen, enthaltend Alkalisierungsmittel in einem Lösemittel, gekennzeichnet durch zusätzlich enthaltene lösliche Silikate.

20

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch lösliche Silikate, ausgewählt aus der Gruppe der Verbindungen, umfassend Alkalimetallsilikate, Ammoniumsilikate und substituierte Ammoniumsilikate.

25

3. Zusammensetzung nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch Natriumsilikate oder Kaliumsilikate als Alkalimetallsilikate.

4. Zusammensetzung nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch Tetramethylammoniumsilikat als substituiertes Ammoniumsilikat.

30

5. Zusammensetzung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die löslichen Silikate in einer Konzentration von 0,02 g Silizium/Liter Zusammensetzung bis 40 g Silizium/Liter Zusammensetzung

vorliegen.

6. Zusammensetzung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die löslichen Silikate in einer Konzentration von 0,2 g Silizium im Silikat/Liter Zusammensetzung bis 20 g Silizium im Silikat/Liter Zusammensetzung vorliegen.
5
7. Zusammensetzung nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch Alkalisierungsmittel, ausgewählt aus der Gruppe der Verbindungen, umfassend Alkanolamine mit ein bis zehn Kohlenstoffatomen, Cholinbasen, Alkalimetallhydroxide und substituierte Ammoniumhydroxide.
10
8. Zusammensetzung nach einem der vorstehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch Ethanolamin als Alkalisierungsmittel.
15
9. Verwendung einer Zusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 8 zum Entfernen von Resistschichten von Metalloberflächen durch In-Kontakt-Bringen der Metalloberfläche mit der Zusammensetzung.
20
10. Verwendung nach Anspruch 9 zum Entfernen von Resistschichten von Leiterplattenoberflächen.
25
11. Zusammensetzung zum Entfernen von polymeren Resistschichten von Substratoberflächen, gekennzeichnet durch einzelne oder alle neuen Merkmale oder Kombinationen der offenbarten Merkmale.
30
12. Verwendung einer Zusammensetzung zum Entfernen von polymeren Resistschichten von Substratoberflächen, gekennzeichnet durch einzelne oder alle neuen Merkmale oder Kombinationen der offenbarten Merkmale.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/EP 95/00858

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G 03 F 7/32, G 03 F 7/42, C 09 K 13/06, H 05 K 3/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G 03 F, C 09 K, H 05 K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP, A, 0 492 959 (FUJI PHOTO FILM CO. LTD.) 01 July 1992 (01.07.92), claims 1-3,10; page 4, lines 34-40. --	1-12
X	EP, A, 0 097 282 (SHIPLEY COMPANY INC.) 04 January 1984 (04.01.84), claims 1,2,4,8; example 3. --	1-3, 5-7, 9-12
X	EP, A, 0 062 733 (SHIPLEY COMPANY INC.) 20 October 1982 (20.10.82), claims 1,2,4-7,15. --	1,2, 4,7, 9-12
X	EP, A, 0 209 152 (PETRACH SYSTEMS INC.)	1-3,7, 9-12

<input type="checkbox"/>	Further documents are listed in the continuation of Box C.	<input type="checkbox"/>	See patent family annex.
"A"	Special categories of cited documents: document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	"T"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"E"	earlier document but published on or after the international filing date	"X"	document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)	"Y"	document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"O"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means	"&"	document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search 10 July 1995 (10.07.95)	Date of mailing of the international search report 27 July 1995 (27.07.95)
Name and mailing address of the ISA/ European Patent Office Facsimile No.	Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/EP 95/00858

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	21 January 1987 (21.01.87), claims 1,6-9. --	
X	EP, A, 0 209 153 (PETRACH SYSTEMS, INC.) 21 January 1987 (21.01.87), claims 1-3,5-10. --	1-3, 5-7, 9-12
X	DD, A, 277 773 (AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER DDR) 11 April 1990 (11.04.90), abstract, page 2 line 6-8,26-31. --	1-3,7, 9-12
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, unexamined applications. P Section, volume 13, No 361, published on 1989 11 August, THE PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT, page 93 P 917; & JP-A-01 120 552 (TAMA KAGAKU KOGYO K.K.) ----	1-4,7, 9-12

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern Wes Aktenzeichen
PCT/EP 95/00858

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES			
G 03 F 7/32, G 03 F 7/42, C 09 K 13/06, H 05 K 3/06			
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC 6			
B. RECHERCHIERTE GEBIETE			
Recherchiertes Mindestprästoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)			
G 03 F, C 09 K, H 05 K			
Recherchierte aber nicht zum Mindestprästoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen			
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)			
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN			
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
X	EP, A, 0 492 959 (FUJI PHOTO FILM CO. LTD.) 01 Juli 1992 (01.07.92), Ansprüche 1-3,10; Seite 4, Zeilen 34-40. --	1-12	
X	EP, A, 0 097 282 (SHIPLEY COMPANY INC.) 04 Jänner 1984 (04.01.84), Ansprüche 1,2,4,8; Beispiel 3. --	1-3, 5-7, 9-12	
X	EP, A, 0 062 733 (SHIPLEY COMPANY INC.) 20 Oktober 1982 (20.10.82), Ansprüche 1,2,4-7,15. --	1,2, 4,7, 9-12	
X	EP, A, 0 209 152 (PETRACH SYSTEMS INC.) --	1-3,7, 9-12	
<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen		<input type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie	
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist			
T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Veröffentlichung für einen Fachmann nahelegend ist *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist			
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 10 July 1995		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 27.07.95	
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax (+ 31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter SCHÄFER e.h.	

III. EINSCHLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN (Fortsetzung von Blatt 2)		
Art *	Kennzeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	21 Jänner 1987 (21.01.87), Ansprüche 1,6-9. --	
X	EP, A, 0 209 153 (PETRACH SYSTEMS, INC.) 21 Jänner 1987 (21.01.87), Ansprüche 1-3,5-10. --	1-3, 5-7, 9-12
X	DD, A, 277 773 (AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER DDR) 11 April 1990 (11.04.90), Zusammenfassung; Seite 2, Zeilen 6-8,26-31. --	1-3,7, 9-12
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, unexamined applications, P Sektion, Band 13, Nr. 361, veröffentlicht 1989, 11 August, THE PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT, Seite 93 P 917; & JP-A-01 120 552 (TAMA KAGAKU KOGYO K.K.) -----	1-4,7, 9-12

ANHANG

zum internationalen Recherchenbericht über die internationale Patentanmeldung Nr.

ANNEX

to the International Search Report to the International Patent Application No.

ANNEXE

au rapport de recherche international relatif à la demande de brevet international n°

PCT/EP 95/00858 SAE 107510

- In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
- Diese Angaben dienen nur zur Orientierung und erfolgen ohne Gewähr.

This Annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The Office is in no way liable for these particulars which are given merely for the purpose of information.

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents de brevets cités dans le rapport de recherche international visée ci-dessus. Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office.

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument Patent document cited in search report	Datum der Veröffentlichung Publication date	Mitglied(er) der Patentfamilie Patent family member(s)	Datum der Veröffentlichung Publication date
Document de brevet cité dans le rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevets	Date de publication
EP A1 492959	01-07-92	JP A2 5002277 US A 5250399 JP A2 4219759	08-01-93 08-10-92 10-08-92
EP A2 97282	04-01-84	EP A3 27282 EP A2 5906280 US A 4628003 CO 324682004 JP A1 5472466 JP A1 6274466 JP A2 5800614 JP B4 3026380	25-07-84 10-04-84 09-12-86 13-02-86 20-10-86 02-01-86 10-01-86 10-04-91
EP A1 62733	20-10-82	DE CO 3268203 DE CO 3274003 JP A2 5800614 JP B4 3026380 US A 4628003 CO A 4628003 JP A2 972466 JP A3 972466 JP A2 5906280	13-02-86 03-01-86 10-01-86 10-04-84 09-12-86 04-01-86 25-07-84 10-04-84
EP A2 209152	21-01-87	CA A1 1285418 CA CO 1285424 CA A2 1209153 CA A2 6207854 CA B1 70062004 US A 4931380	02-07-91 20-04-90 26-10-90 20-03-90 10-04-87 27-08-90 05-06-90
EP A2 209153	21-01-87	CA A1 1281578 DE CO 40088481 DE DE 40088481 JP T3 600910041 JP A2 209153 JP A2 6207854 CA B1 900220047 US A 4822722	19-03-91 01-07-91 16-09-91 20-09-91 28-05-91 10-04-91 06-04-90 18-04-90
DD A1 277773	11-04-90	keine - none - rien	